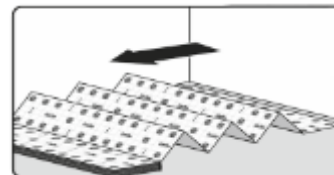


[331] GERFLOR SILENCE PLUS 19 DB

Należy skontrolować wszystkie podkłady pod kątem widocznych uszkodzeń przed montażem. Po wykryciu widocznych wad należy powiadomić firmę GERFLOR i zaniechać montażu do momentu uzyskania zgody na użycie produktu.

PODKŁAD GERFLOR SILENCE PLUS 19 DB

Opakowanie	Paczka 10 m ² (8,47 x 1,18 m)
Grubość	1,5 mm
Kolory	biały
Rodzaj powierzchni po stronie płytki lub panelu	Powierzchnia z nadrukami



OPIS: Podkład dużej gęstości z polistyrenu ekspandowanego (XPS) do użytku z następującymi produktami: CREATION 30 CLIC / CREATION 55 CLIC / VIRTUO 30 CLIC / VIRTUO 55 CLIC

1. ZASTOSOWANIE

TEMPERATURA MONTAŻU:	+15°C < T < +26°C (idealnie: 20°C)
TEMPERATURA UŻYTKOWANIA:	+10°C < T < +30°C
BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE (NASŁONECZNIONY OBSZAR PRZY OKNACH WYKUSZOWYCH, ŚWIETLIKACH, ŚWIETLIKACH KOPUŁKOWYCH ITP.)	Podkład można układać luźno pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby zapobiec osiągnięciu przez posadzkę temperatury 60°C lub więcej, należy zabezpieczyć posadzkę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. poprzez użycie zasłon, żaluzji itp. rozwiązania. Przy braku takich rozwiązań należy przykleić produkt w formie paneli lub płytek przy pomocy odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju).
WERANDY	Niedozwolone niezależnie od podłoża.

2. PODŁOŻA

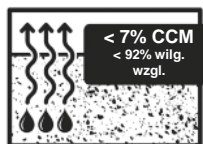
GLADKIE PŁYTKI CERAMICZNE	Na powierzchni nie może być żadnych nierówności, szerokość fug nie może przekraczać 4 mm, a ich głębokość 1 mm. Ewentualne nierówności należy wypełnić zaprawą do fugowania lub wylewką wykonywaną na całej powierzchni, bez pozostawiania widocznych fug (aby zapobiec śladom fug na gotowej posadzce).
POSADZKA BETONOWA, MALOWANY BETON, WYLEWKI BETONOWE, JASTRYCHY CEMENTOWE LUB ANHYDRYTOWE	Podkład pod posadzkę musi być równy, płaski, czysty, pozbawiony zanieczyszczeń, solidny, suchy, twardy, pozbawiony pęknięć i nienarażony na działanie wilgoci. Zawsze należy stosować wylewkę do podłóg w celu całkowitego wyeliminowania nierówności powierzchni. Zeszlifować, odpylić zgodnie z instrukcją producenta.
PŁYTKI PVC I WYKŁADZINY W ROLKACH	Jeśli spełniono wymagania odnośnie podłoża, a ponad 90% powierzchni pomieszczenia jest w dobrym stanie, to należy usunąć uszkodzone płytki, wypełnić ubytki za pomocą wylewki do podłóg, a następnie położyć podkład GERFLOR SILENCE PLUS 19 DB po wyschnięciu podkładu betonowego. W przeciwnym razie należy zdemontować całą posadzkę i przygotować całe podłoże od początku.
PVC NA SPODZIE Z PIANKI	Niedozwolone
WYKŁADZINY TEKSTYLNE (DYWANOWE)	Niedozwolone Zdemontować posadzkę i przygotować podłoże od początku.
PŁYTKI WINYLOWO-AZBESTOWE	Patrz instrukcja techniczna firmy Gerflor dot. przekrywania podłóg azbestowych udostępniona przez producenta (www.gerflor.com).
POSADZKI Z PŁYT DREWNOPOCHODNYCH NA BELKACH STROPOWYCH LUB NA KANTÓWKACH (DTU 51.3)	Dopuszczalne
PARKIET KLEJONY	Całkowity demontaż
PARKIET MOCOWANY GWOŹDIAMI DO BELEK, Z ELEMENTAMI ROZMIESZCZONYMI W ODLEGŁOŚCI MAKS. 0,30 M, Z WENTYLACJĄ PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ	Dopuszczalne
PARKIET LUB PANEL PŁYWAJĄCY	Całkowity demontaż
PODŁOGI LAMINOWANE	Całkowity demontaż
PŁYTY OSB	Całkowity demontaż lub przykrycie sklejką
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	
OGRZEWANIE PODŁOGOWE Z OBIĘGIEM GORĄCEJ WODY O TEMP. MAKS. 28°C	Dopuszczalne
PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE PODŁOGOWE, WYMAGANA WARTOŚĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI 0,15 M2 x KW	Niedozwolone
NISKOTEMPERATUROWE REWERSYJNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE	Niedozwolone

3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

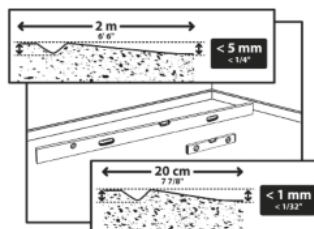
3.1. Warunki podłoża



Podkład należy umieszczać na płaskie, czyste, mocne, suche i solidne podłożu.



Zawartość wilgoci nie może przekraczać wartości 7% w próbie metodą karbidową. (Patrz punkt 3.2).



- Nierówność podłoża musi wynosić poniżej 5 mm przy zastosowaniu 2 m łaty kontrolnej
- Na podłożu nie może być nierówności powyżej 1 mm na 20 cm.
- Podłoże musi być gładkie i odpylone.

3.1.1 Podłoże z płytek



- Maksymalna szerokość spoin/fug między płytkami 4 mm.

3.2. PRZYGOTOWANIE NOWEGO PODŁOŻA BETONOWEGO

Powierzchnię należy starannie przygotować, dokładnie usuwając zanieczyszczenia i brud, mleczo betonowe, resztki produktów wykończeniowych i wszelkie ciała obce.

Jeżeli podłoże nie spełnia wymagań, należy przygotować je w następujący sposób:

- **Zawartość wilgoci w podłożu < 4,5% / 75% wilg. względnej:** musi spełniać wymogi dla klasy specyfikacji P3.
- **Zawartość wilgoci w podłożu od 4,5 do 7% i/lub 75 do 92% wilgotności względnej:** W takiej sytuacji zaleca się wykonanie izolacji poziomej przed nałożeniem zaprawy wyrównującej lub hydroizolacji.

• Wyrównywanie punktowe:

Do naprawy punktowej nierówności i ubytków można użyć zaprawy żywicznej (z oznaczeniem NF dla produktów do napraw betonu).

- **Naprawa pęknięć:** naprawić pęknięcia przed nałożeniem zaprawy naprawczej w przypadku obszaru nierówności przekraczających 1 mm lub w razie szczelin większych niż 1 mm.

• Obróbka połączeń:

- Dylatacje skurczowe: przygotować połączenie przed nałożeniem zaprawy naprawczej, jeśli nierówność przekracza 1 mm lub w razie szczelin większych niż 4 mm.
- Przeny robocze: postępowanie takie, jak w przypadku pęknięć.

4. MONTAŻ PODKŁADU

4.1. PODZIAŁ POMIESZCZENIA

Każde zamknięte pomieszczenie należy traktować osobno. Wymagania odnośnie podziału:

- Przy powierzchniach powyżej 150 m², należy podzielić obszar 150 m² poprzez zamocowanie podkładu do podłoża za pomocą taśmy dwustronnej Fix & Free 100 (nr katalogowy 058U0001, szerokość 10 cm).
- Co 10 m wzdłuż dłuższego boku panelu lub płytki. Obszar należy podzielić na równe obszary. np.: 12 m --> 2 x 6 m, 16 m --> 2 x 8 m, 20 m --> 2 x 10 m, 24 m --> 3 x 8 m, 40 m --> 4 x 10 m.
- Przy progach lub wokół rur.
- Sposób ułożenia paneli/płytek musi odpowiadać układowi elementów na podkładzie.

4.2. UKŁADANIE NA PŁASKO

- Podkład przechowywać w miejscu, gdzie nastąpi ich montaż, przez co najmniej 24 godziny przed montażem (min. temperatura otoczenia 20°C).
- Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 15 do 26°C.

- Podkład należy układać stroną zadrukowaną do góry, w ten sam sposób, co panele/płytki.

- Rozwijając podkład w kierunku ściany z największym oknem albo wzdłuż pomieszczenia.

4.3. MONTAŻ

- Elementy podkładu należy ułożyć na całej powierzchni podłogi.
- Pasy podkładu oraz złącza doczołowe na górnej powierzchni należy łączyć za pomocą cienkiej jednostronnej taśmy klejącej (szer. 75 mm, Alu Tape, numer do zamawiania Gerflor: 59500001).
- Rozciągnąć i rozplaszczyc podkład ręcznie, aby usunąć fałdy i wybrzuszenia.
- **Płytki lub deski najlepiej kłaść w tym samym kierunku, co podkład.**
- Przycinać podkład wzdłuż ścian lub zamontowanych listw podłogowych, korzystając z nadrukowanych linii przerywanych. Pozostawić 5 mm dylatację przy krawędzi.
- Należy unikać układania połączeń podkładu i połączeń panel-płytki obok siebie.
- Układać panele/płytki zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi montażu VIRTUO 30 / 55 CLIC i CREATION 30 / 55 CLIC.

